

BCL-SMT 3.81/11/90F 1.5SN BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Les connecteurs femelles inversés pour circuit imprimé BCL-SMT présentent trois avantages essentiels : Les BCL-SMT

- évitent le contact avec les doigts sur le circuit imprimé et permettent l'utilisation de sorties sous tension
- rendent possible le raccordement carte-carte
- sont compatibles avec la refusion et peuvent s'intégrer dans un process d'implantation automatique et un process de soudage

Deux orientations de sortie offrent une grande liberté de conception pour différentes variantes d'agencement :

- Debout 180°
- Couché 90°

2 variantes de boîtiers de la BCL-SMT sont disponibles :

- sans bride
- Avec bride à souder inversée (« LFI », avec écrou)
- Fixation sur le circuit imprimé sans vissage additionnel
- Fixation à vis sur la SCZ FI

Le layout des connecteurs enfichables à pas de 3,81 mm (0.15 pouces) de Weidmüller est compatible avec les connecteurs enfichables courants et laisse de la place pour l'impression et le codage.

Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Bride, Raccordement soudé THT/THR, 3.81 mm, Nombre de pôles: 11, 90°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte
Référence	1975820000
Type	BCL-SMT 3.81/11/90F 1.5SN BK
GTIN (EAN)	4032248678525
Qté.	50 pièce(s)
Indices de produit	IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A
Emballage	Boîte

BCL-SMT 3.81/11/90F 1.5SN BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 4,363 g

Classifications

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ECLASS 9.0	27-44-04-02
ECLASS 9.1	27-44-04-02	ECLASS 10.0	27-44-04-02
ECLASS 11.0	27-46-02-01	ECLASS 12.0	27-46-02-01

Caractéristiques du système

Famille de produits	OMNIMATE Signal - série BC/SC 3.81		
Type de raccordement	Raccordement sur platine		
Montage sur le circuit imprimé	Raccordement soudé THT/THR		
Pas en mm (P)	3,81 mm		
Pas en pouces (P)	0,15 inch		
Angle de sortie	90°		
Nombre de pôles	11		
Nombre de picots par pôle	2		
Longueur du picot à souder (l)	1,5 mm		
Tolérance sur la longueur du picot à souder	0 / -0,02 mm		
Dimensions du picot à souder	d = 0,8 mm		
Dimension du picot à souder = tolérance +0,05 / -0,05 mm	d		
Diamètre du trou d'implantation (D)	1,2 mm		
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D)	+ 0,1 mm		
Diamètre extérieur du plot de soudure	1,9 mm		
Diamètre du trou de l'écran	1,6 mm		
L1 en mm	38,1 mm		
L1 en pouce	1,5 inch		
Nombre de rangs	1		
Nombre de pôles	1		
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106	protection doigt		
Protection au toucher selon DIN VDE 0470	IP 20		
Résistance de passage	≤5 mΩ		
Codable	Oui		
Couple de serrage pour bride vissée, min.	0,2 Nm		
Couple de serrage pour bride vissée, max.	0,3 Nm		
Force d'enfichage/pôle, max.	9,5 N		
Force d'extraction/pôle, max.	6 N		
Couple de serrage	Type de couple	Vis de fixation, Circuit imprimé	
	Informations d'utilisation	Couple de serrage	min. 0,1 Nm max. 0,15 Nm
		Vis recommandée	Numéro de pièce PTSC KA 2.2X4.5 WN1412

BCL-SMT 3.81/11/90F 1.5SN BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


Caractéristiques techniques**Données des matériaux**

Matériau isolant	LCP GF	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Groupe de matériaux isolants	IIIa
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	≥ 175	Moisture Level (MSL)	1
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau des contacts	Alliage de cuivre
Surface du contact	étamé	Structure en couches du raccordement soudé	1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn mat
Structure en couches du contact mâle	1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn mat	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de fonctionnement, min.	-50 °C
Température de fonctionnement, max.	120 °C	Plage de température montage, min.	-25 °C
Plage de température montage, max.	120 °C		

Données nominales selon CEI

testé selon la norme	IEC 60664-1, IEC 61984	Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)	17,5 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)	15,4 A	Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)	17,5 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C)	13,7 A	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2	320 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2	160 V	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3	160 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2	2,5 kV	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2	2,5 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3	2,5 kV	Tenue aux courants de faible durée	3 x 1s mit 76 A

Données nominales selon CSA

Institut (CSA)		Certificat N° (CSA)	200039-1121690
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)	300 V	Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA)	50 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA)	11 A	Courant nominal (groupe d'utilisation C / CSA)	11 A
Référence aux valeurs approuvées	Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.		

Données nominales selon UL 1059

Institut (cURus)		Certificat N° (cURus)	E60693
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)	300 V	Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059)	300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059)	10 A	Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)	10 A
Référence aux valeurs approuvées	Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.		

BCL-SMT 3.81/11/90F 1.5SN BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Emballage**

Emballage	Boîte	Longueur VPE	0 mm
Largeur VPE	0 mm	Hauteur VPE	0 mm

Note importante

Conformité IPC	Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité moyenne de 70 %, 36 mois

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E60693

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Declaration of the Manufacturer
Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL DRIVES EN MB SMT EN FL DRIVES DE MB DEVICE MANUF. EN FL BUILDING SAFETY EN FL APPL LED LIGHTING EN FLIndustr.CONTROLS EN FL MACHINE SAFETY EN FL HEATING ELECTR EN FL APPL INVERTER EN FL_BASE_STATION EN FL ELEVATOR EN FL POWER SUPPLY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN
Livre blanc technologie de montage en surface	Download Whitepaper

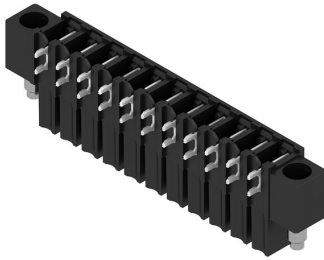
BCL-SMT 3.81/11/90F 1.5SN BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

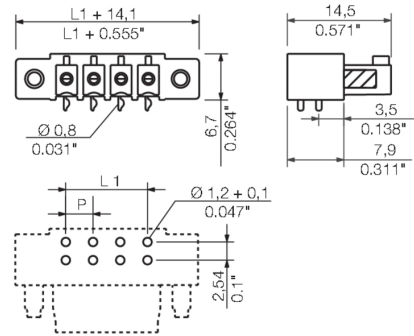
www.weidmueller.com

Dessins

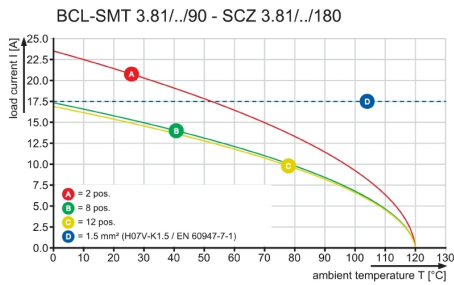
Illustration du produit



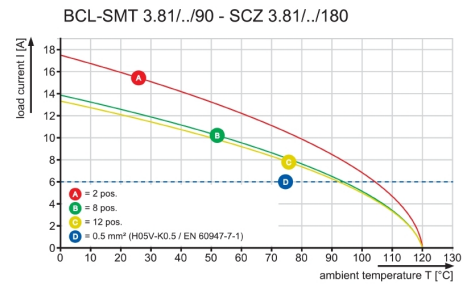
Dimensional drawing



Graph

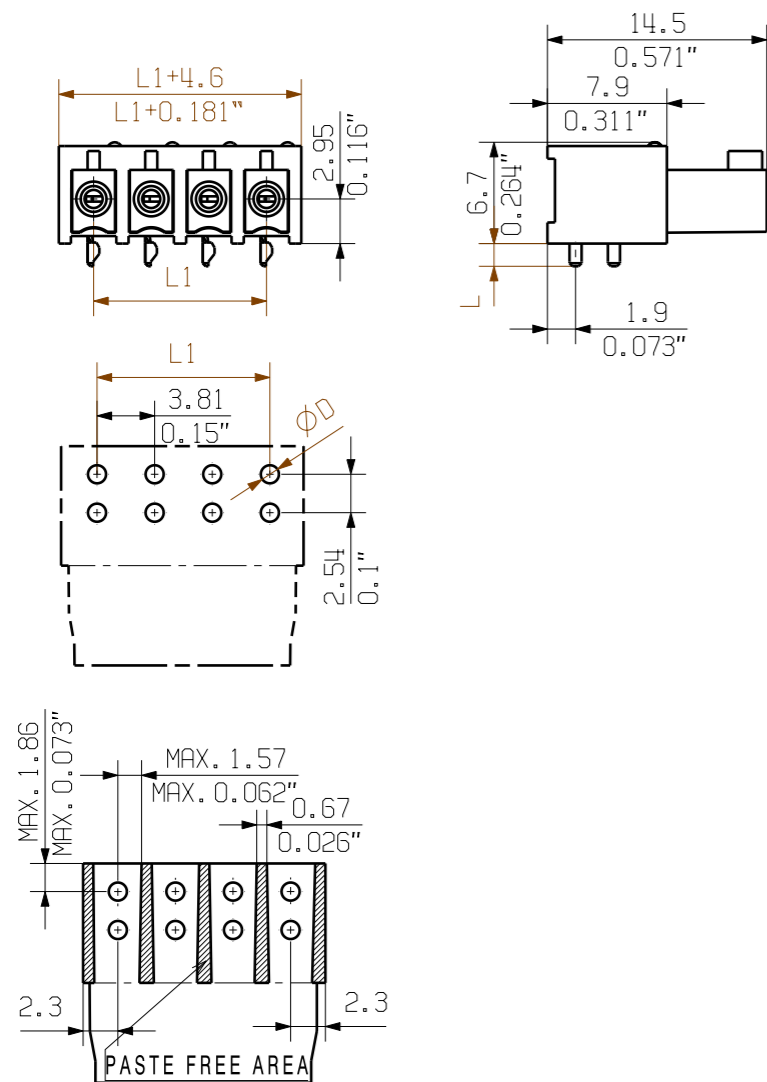


Graph

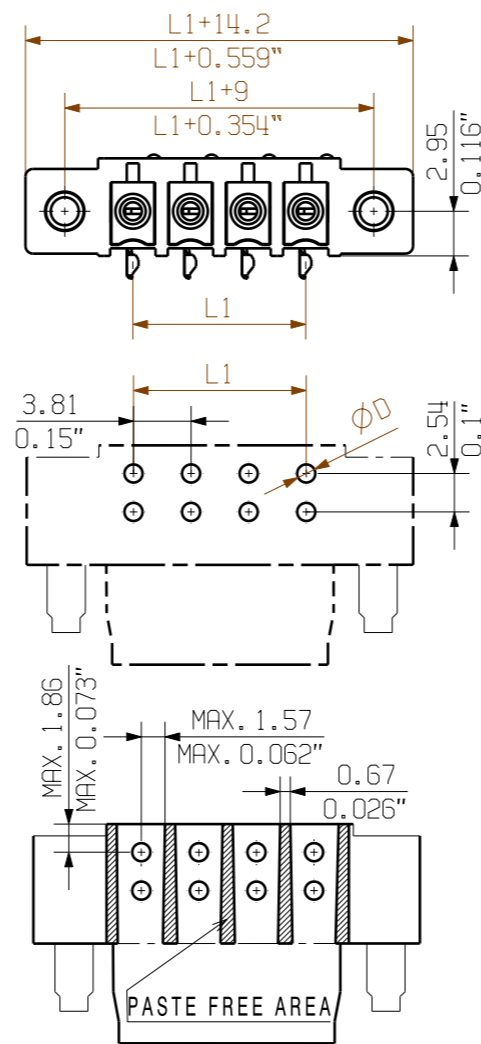


07

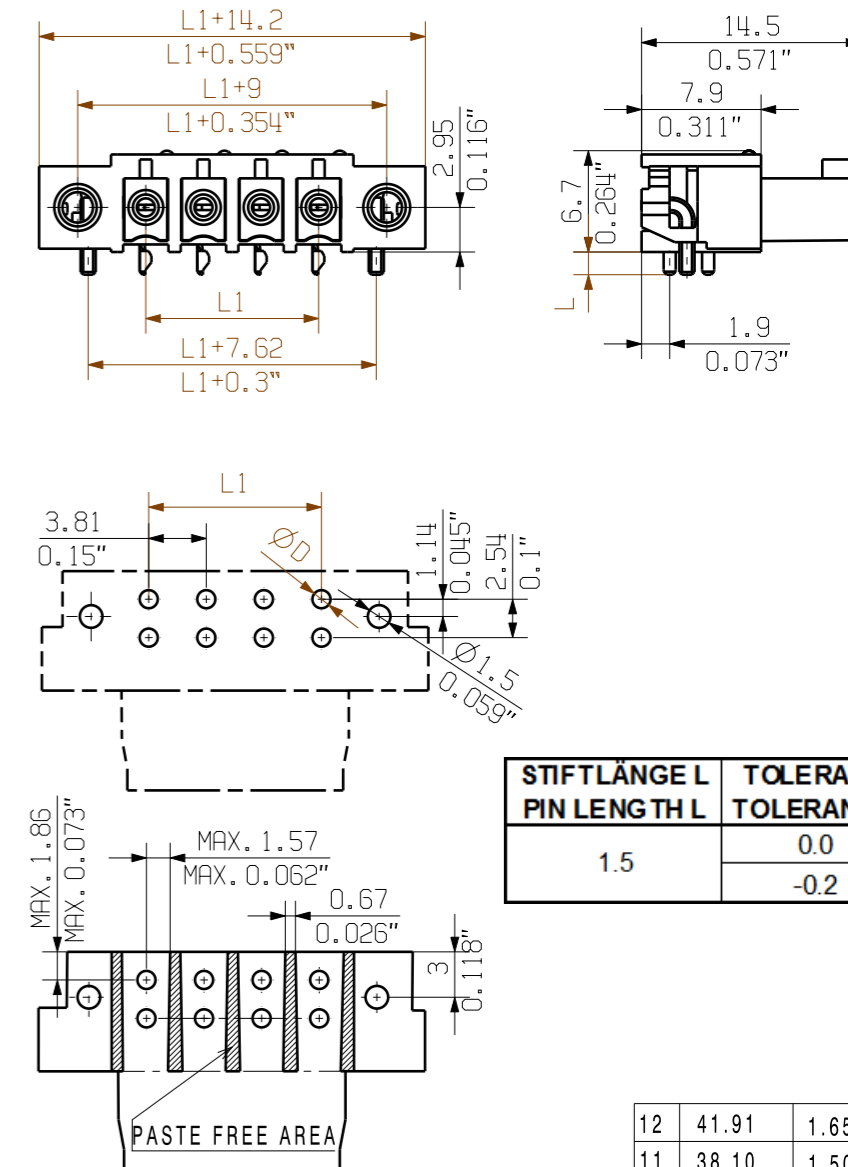
BCL-SMT 3.81/.../90 1.5...



BCL-SMT 3.81/.../90F 1.5...



BCL-SMT 3.81/.../90LFI 1.5...



STIFTLÄNGE L PIN LENGTH L	TOLERANZ TOLERANCE
1.5	0.0 -0.2

12	41.91	1.650
11	38.10	1.500
10	34.29	1.350
9	30.48	1.200
8	26.67	1.050
7	22.86	0.900
6	19.05	0.750
5	15.24	0.600
4	11.43	0.450
3	7.62	0.300
2	3.81	0.150
N	L1 [mm]	L1 [inch]

KUNDENZEICHNUNG
CUSTOMER DRAWING

PCB HOLE DIAMETER D WAVE SOLDERING 1.2mm/0.047inch
REFLOW SOLDERING 1.3mm/0.051inch

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data stated here relates only to the PCB components alone.

The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to IEC 664 / VDE 0110.

The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller PCB components are tested to the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application.

Provided that the components are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

GENERAL TOLERANCE: DIN ISO 2768-m		88921/5 06.07.16 MA_J 01		Weidmüller		C 40404 07	
RoHS COMPLIANT Max. nos.		Modification		Drawing no.		Issue no.	
Scale: 2/1		Date		Name		Sheet 01 of 05 sheets	
Supersedes: .		Drawn		Responsible		Product file: BCL-SMT 3.81	
Approved		Date		Name		Product file: BCL-SMT 3.81	

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klängenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is ‚activated‘. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.